

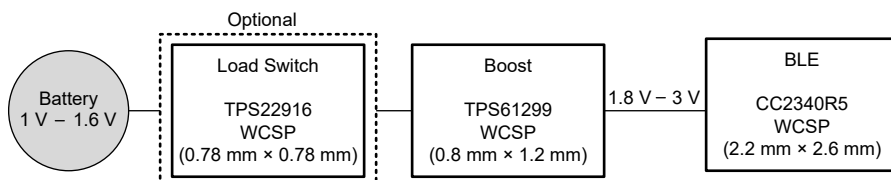
## Product Overview

# 利用先进的电池化学物质 解决互联设备的超低功耗挑战

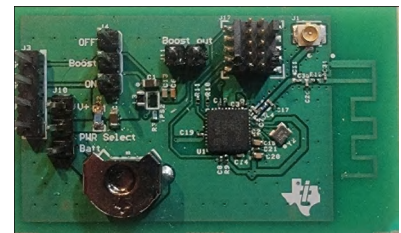


### 说明

随着人们越来越需要更小的低功耗互联设备，系统面临着如何实现超低静态和关断电流以及适应更低电源电压的双重挑战。先进的电池制造技术将氧化银和锌空气等高功率密度化学物质用于更多设备中，包括医疗可穿戴设备、物联网 (IoT) 设备和测量仪器仪表。这就需要小型互联系统在低至 1V 的电源电压下工作，并且关断电流为数十纳安级别。



方框图



实现示例

### 特性

- 使用 1.5V 电源和超少器件数时，有源待机系统级电流低至 1 $\mu$ A。
- 货架模式和运输模式系统级电流在无负载开关时低至 60nA，在有负载开关时低至 10nA。

### 应用

- 医疗传感器贴片
- 连续血糖监测仪
- 助听器
- 胰岛素泵

### 推荐使用的器件

器件型号	范围	待机电流	关断电流	封装	特性
CC2340R5	1.71V 至 3.8V	700nA	150nA	QFN (4mm x 4mm) WCSP (2.2mm x 2.6mm)	低功耗 Bluetooth® 5.3 , 12 位 ADC
TPS61299	0.7V 至 5.5V	155nA	60nA	WCSP (1.2mm x 0.8mm)	在负载范围内具有高效率
TPS22916	1.0V 至 5.5V	500nA	10nA	WCSP (0.78mm x 0.78mm)	低漏电流负载开关

### TI 资源

- 面向 CC23XX 的 SimpleLink Academy
- SimpleLink 低功耗 F3 文档概述
- SimpleLink 2.4GHz 硬件设计审查

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司